

## 日本PCB技术的窗口:时流科技

「时流科技」公司能指导你入门掌握日本先进的印制技术。在刚性印制板、挠性印制板、多层印制板、积层印制板（微米级孔）、球珊阵列（BGA）、芯片级封装（CSP）、模块、带载自动安装等领域都能提供指导。包括印制板材料、设备、技术。

由于对电子技术的掌握和在日本PCB行业的丰富的经验、使我们有能力提供下列的技术指导。

1. 对印制电路板技术、挠性电路板、带载自动安装、先进封装、及使用电子材料、帮助制定建厂计划、提供技术指导、技术支援。
  - 刚性印制板、挠性电路板、带载自动安装电路板
  - 球珊阵列（BGA）、芯片级封装（CSP）、多芯片组件
  - 积层印制板（微米级孔）
2. 对计划设立印制电路板，带载自动安装电路板、先进封装等生产线的企业、帮助规划、设计
  - 一揽子服务
  - 设备引进安装服务
3. 微电子行业的国际生产许可和顾问业务
  - 现有技术及将来技术
  - 技术转移
4. 提供微电子产品的技术服务、销售代理
  - 市场开发
  - 先进产品的代理销售业务
5. 微电子行业的合作、取得

贵公司有具体的要求请联系下面电子信箱或传真

### <总经理简介>

**平川 董** (Hirakawa-Tadashi)

从事电子技术开发有20年经验。主要从事新型印制电路板材料、激光打孔高密度技术电路板、带载自动安装电路板等研究开发、申请专利120件、有许多实际成果、曾任帝人株式会社研究开发部部长、富士机工电子株式会社副总经理、技术部长。1998年起设立「时流科技股份有限公司」、一贯从事对日本各知名企业的经营、规划和技术指导工作。

